

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 10 月 2 日(02.10.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/156834 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/06 (2006.01) H03H 9/25 (2006.01)
H03H 3/08 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/057335
- (22) 国際出願日: 2014 年 3 月 18 日(18.03.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-069693 2013 年 3 月 28 日(28.03.2013) JP
特願 2014-022300 2014 年 2 月 7 日(07.02.2014) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 豊田 英志(Toyoda, Eiji); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 清水 祐作(Shimizu, Yusaku); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 石坂 剛(Ishizaka, Tsuyoshi); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒

5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 1 3
— 9 新大阪MTビル 1 号館 Osaka (JP).

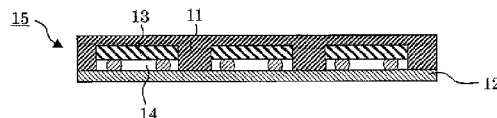
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: HOLLOW SEALING RESIN SHEET AND PRODUCTION METHOD FOR HOLLOW PACKAGE

(54) 発明の名称: 中空封止用樹脂シート及び中空パッケージの製造方法



(57) Abstract: Provided are a hollow sealing resin sheet which is capable of preparing hollow packages in high yield even if the width of the void in the hollow structure is approximately 100 μm , and a production method for a hollow package. This hollow sealing resin sheet includes an inorganic filler in an amount of 70 vol% to 90 vol% inclusive, and the particle size distribution of the inorganic filler measured by means of a laser diffraction scattering method satisfies the following when the total amount of the inorganic filler is 100 vol%. Over 100 μm : 1 vol% or less; 10 μm or smaller: 30 vol% to 70 vol%; 1 μm or smaller: 10 vol% or more.

(57) 要約: 中空構造の空隙の幅が 100 μm 程度であっても高い歩留まりで中空パッケージを作製可能な中空封止用樹脂シート及び中空パッケージの製造方法を提供する。本発明の中空封止用樹脂シートは、無機充填剤を 70 体積%以上 90 体積%以下の含有量で含み、前記無機充填剤の全量を 100 体積%とした際の前記無機充填剤のレーザー回折散乱法により測定した粒度分布が以下を満たす。 100 μm 超: 1 体積%以下 10 μm 以下: 30 体積%以上 70 体積%以下 1 μm 以下: 10 体積%以上

WO 2014/156834 A1